



TIF™700P系列是一种硅胶导热材料，它能填充发热器件和散热片或金属底座二者之间的间隙。它的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。其优异的效能使热量从发热器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上，从而提高发热电子组件的效率和使用寿命。

特性

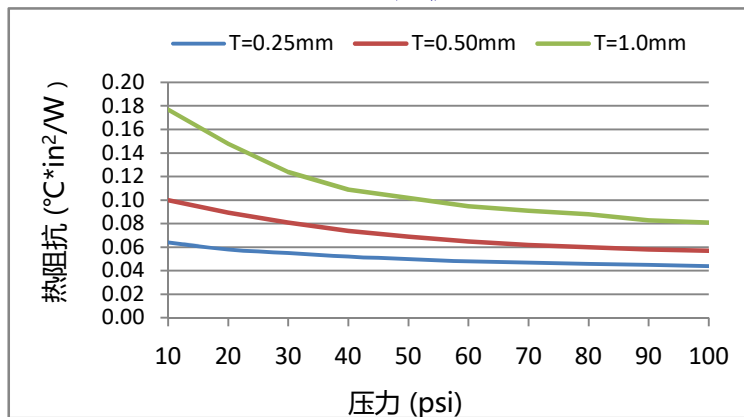
- 》良好的热传导率: **7.5W/mk**
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于低压力应用环境
- 》可提供多种厚度选择

应用

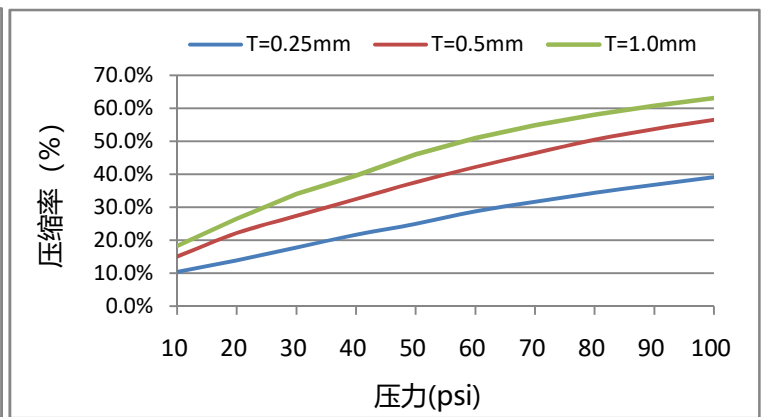
- 》散热器底部或框架
- 》机顶盒
- 》电源与车用蓄电池
- 》充电桩
- 》LED电视, 灯具
- 》显卡模组

| TIF™700P 系列特性表 | | |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 产品特性 | 典型值 | 测试方法 |
| 颜色 | 灰色 | Visual |
| 结构&成份 | 陶瓷填充硅橡胶 | ***** |
| 厚度范围 | 0.010"(0.25mm)~0.200" (5.0mm) | ASTM D374 |
| 硬度(Shore00, 厚度 > 0.75mm) | 45 | ASTM 2240 |
| 硬度(Shore00, 厚度 ≤ 0.75mm) | 75 | ASTM 2240 |
| 密度 (g/cc) | 3.3 | ASTM D792 |
| 使用温度范围 | -40~160°C | IEC60068-2-14 |
| 击穿电压 (T=1.0mm, Vac) | ≥5500 | ASTM D149 |
| 介电常数 @1MHz | 4.5 | ASTM D150 |
| 体积电阻率 | ≥1.0X10 ¹² Ohm-cm | ASTM D257 |
| 导热系数 (W/mK) | 7.5 | ASTM D5470 |
| | 7.5 | ISO22007-2.2 |
| 防火等级 | 94 -V0 | UL E331100 |

热阻抗



压缩率



标准厚度:0.010"(0.25mm)~0.200" (5.0mm)

标准尺寸:8"×16" (203mm×406mm)

TIF系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息, 请与本公司联系。

安全处置方法无需特别防护, 存储方法低温干燥, 远离明火, 避免阳光直射即可, 详细方法可参考产品物质安全资料表。

导热材料

导热工程塑料

发热材料

屏蔽材料

发泡硅胶

模切制品

加拿大 Canada

TEL: +001-604-2998559
E-mail: frances@ziitek.com.tw
[Http://www.thermazig.com](http://www.thermazig.com)

台湾 Taiwan

TEL: +886-2-22771007
E-mail: frances@ziitek.com.tw
[Http://www.ziitek.com.tw](http://www.ziitek.com.tw)

东莞 Dongguan

TEL: +86-769-38801208
E-mail: frances@ziitek.com.tw
[Http://www.ziitek.com.cn](http://www.ziitek.com.cn)

昆山 Kunshan

TEL: +86-512-57816297
E-mail: kelvin@ziitek.com
[Http://www.ziitek.com.cn](http://www.ziitek.com.cn)

杭州 Hangzhou

TEL: +86-571-63850366
E-mail: alex@ziitek.com
[Http://www.ziitek.com.cn](http://www.ziitek.com.cn)

长沙 Changsha

TEL: +86-731-86949836
E-mail: jor@ziitek.com
[Http://www.ziitek.com.cn](http://www.ziitek.com.cn)